

# 云浮收购光电器件，档口直营回收

产品名称	云浮收购光电器件，档口直营回收
公司名称	深圳市邵昕电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:深圳市邵昕电子科技 价格:请电话联系或加QQ 回收范围:全系列电子元器件回收
公司地址	深圳市福田区华强北街道佳和华盛大厦
联系电话	0135-30101390 13530101390

## 产品详情

云浮收购光电器件，档口直营回收 收购PLC模块现金交易 内存芯片、存储器、K9K、K9F、K4Shy等、单面机、PIC系列、电脑配件、硬盘、内存条、BGA(南北桥)、芯片、显卡。

mp3、mp4、芯片、收音模块、主控IC BGA(ball grid array) BGA封装实物 BGA封装实物 [1] 球形触点阵列，表面贴装型封装之一。在印刷基板的背面按阵列方式制作出球形凸点用以代替引脚，在印刷基板的正面装配LSI

芯片，然后用模压树脂或灌封方法进行密封。也称为凸点阵列载体(PAC)。引脚可超过200，是多引脚LSI用的一种封装。封装本体也可做得比QFP(四侧引脚扁平封装)小。例如，引脚中心距为1.5mm的360引脚BGA仅为31mm见方；而引脚中心距为0.5mm的304引脚QFP为40mm见方。而且BGA不用担心QFP那样的引脚变形问题。该封装是美国Motorola

公司开发的，首先在便携式电话等设备中被采用，今后在美国有可能在个人计算机中普及。\*初，BGA的引脚(凸点)中心距为1.5mm，引脚数为225。现在也有一些LSI厂家正在开发500引脚的BGA。BGA的问题是回流焊后的外观检查。现在尚不清楚是否有效的外观检查方法。有的认为，由于焊接的中心距较大，连接可以看作是稳定的，只能通过功能检查来处理。美国Motorola公司把用模压树脂密封的封装称为OMPAC，而把灌封方法密封的封装称为GPAC(见OMPAC和GPAC)。之所把它称之为“水晶头”，是因为它的外表晶莹透亮的原因。水晶头适用于设备间或水平子系统的现场端接，外壳材料采用高密度聚。每条双绞线两头通过安装水晶头与网卡和交换机相连。A类B类水晶头制作方式我们一般有两种排线规则。一种是T568B，一种是T568A，大多数我们使用的都是B类接法。具体排线方法是：T568B：“橙白、橙、绿白、蓝、蓝白、绿、棕白、棕”；T568A：“绿白、绿、橙白、蓝、蓝白、橙、棕白、棕”。